



НОРСИ-ТРАНС

Структура и опыт

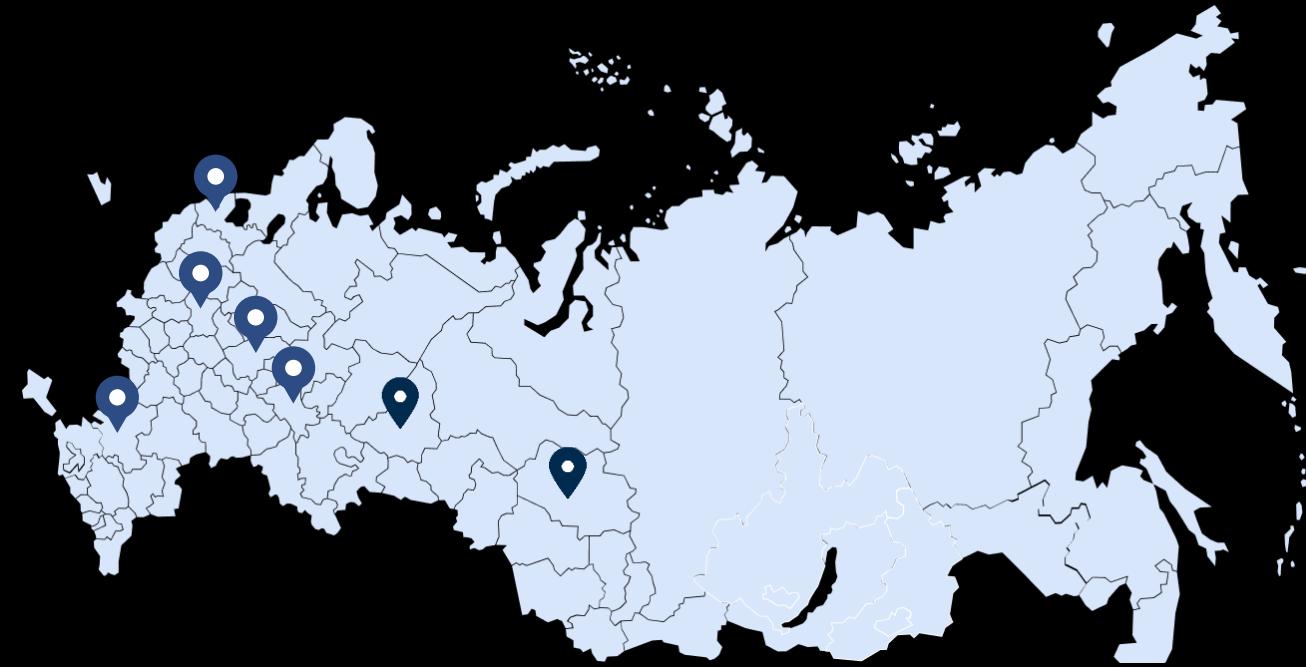
28
лет на рынке

3
конструкторских
бюро

500+
сотрудников

450+
клиентов

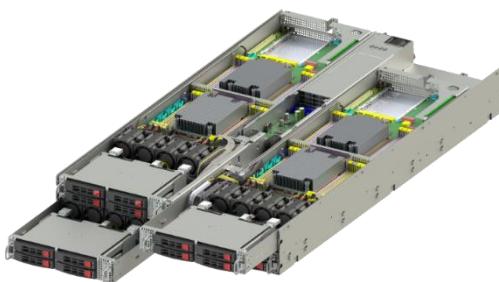
24/7
поддержка



Собственные производства:

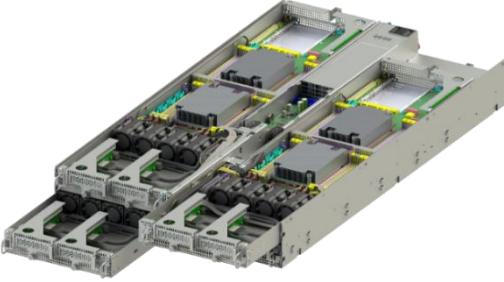
- Корпусов
- SMT-монтажа
- Блоков питания
- Серийная стапельная сборка
- Высокомощных систем теплосъема для электроники

«НТ» Паладин-МШУ (Тип 1)



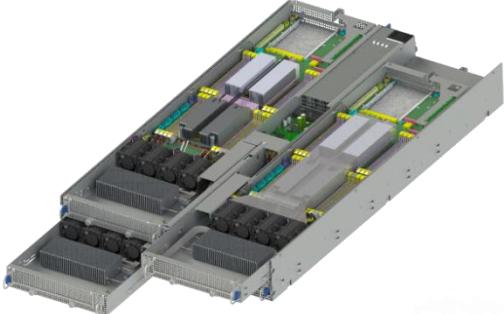
- 4 вычислительных двухпроцессорных модуля с горячей заменой
- 8 x процессоров до 180 Вт**
- 64 x DDR4 3200 МГц
- 16 шт. SFF дисков (PCIe 4x NVMe / SATA / SAS)
- 2x M.2 NVMe
- 4 шт. OCP карт расширения
- 4 шт. PCIe LP карт расширения

«НТ» Паладин-МШУ (Тип 2)



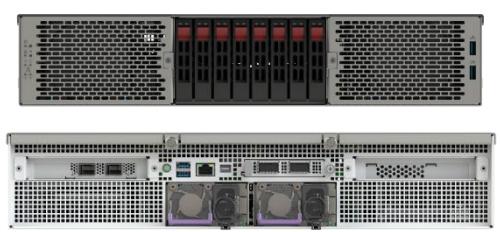
- 4 вычислительных двухпроцессорных модуля с горячей заменой
- 8 x процессоров до 180 Вт**
- 64 x DDR4 3200 МГц
- 2x M.2 NVMe
- 4 шт. OCP карт расширения
- 12 шт. PCIe LP карт расширения

«НТ» Паладин-МШУ (Тип 3)



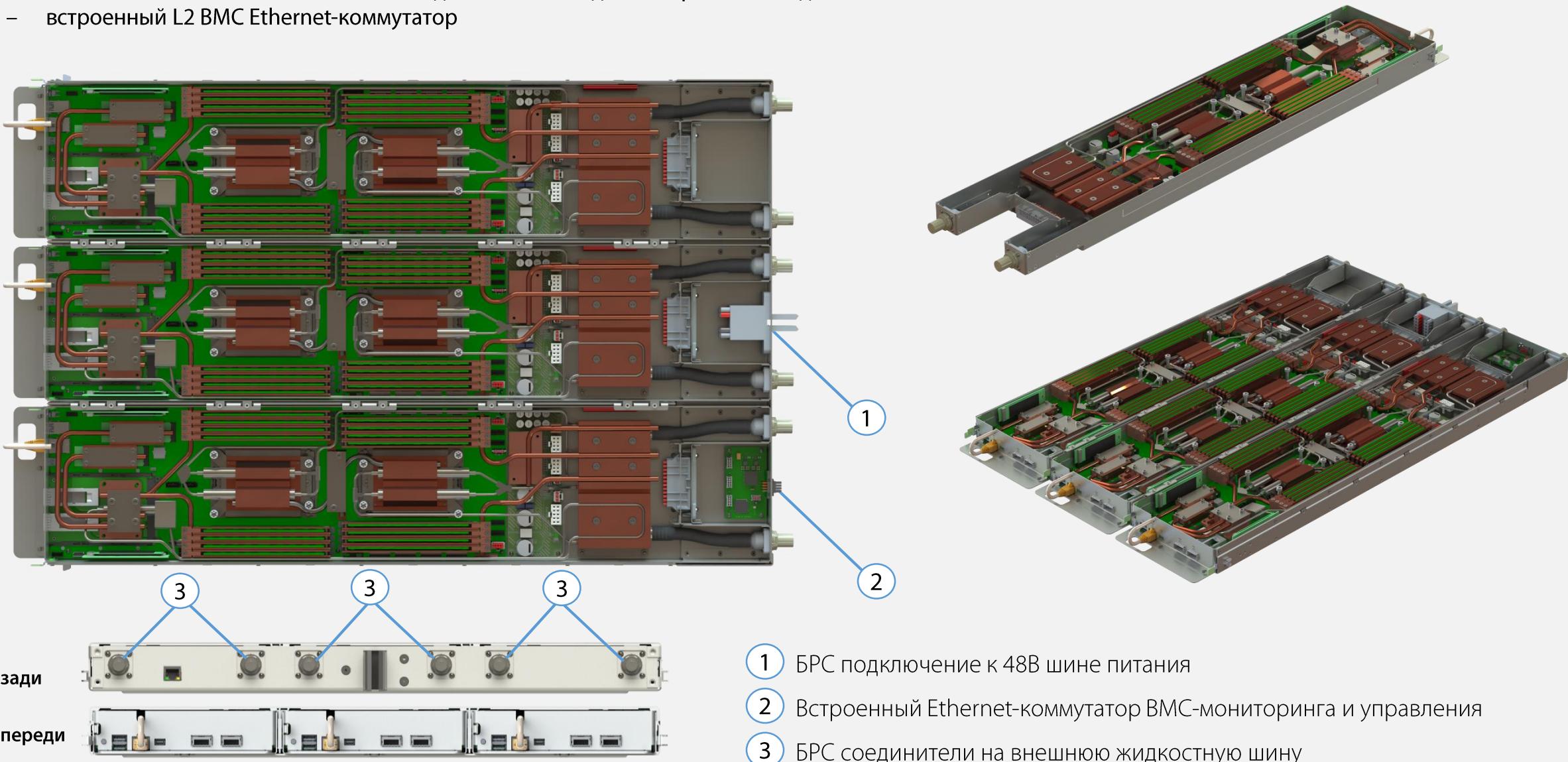
- 4 вычислительных двухпроцессорных модуля с горячей заменой
- 8 x процессоров до 200 Вт**
- 64 x DDR4 3200 МГц
- 2x M.2 NVMe
- 4 шт. OCP карт расширения
- 4 шт. PCIe LP карт расширения

«НТ» Паладин-GPU



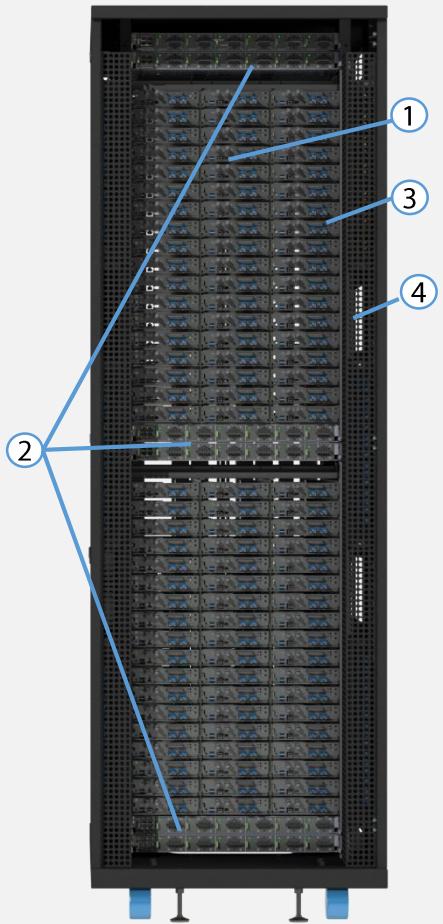
- 2 x процессора до 200 Вт (64 ядра)
- 16 x 64 ГБ DDR4
- 4 шт. NVMe PCIe 4x gen4 либо 6xSAS/SATA
- 2x M.2 NVMe
- 1 шт. OCP PCIe 16x gen4 карта расширения
- 1 шт. PCIe LP 8x gen4 карта расширения
- 6xGPU FHFL PCIe-карты (до 300 Вт), в т.ч. 2 пары с NVLink**

- **3 шт двухпроцессорных матплат**
- КТТ система теплосъема и внешнее жидкостное охлаждение через БРС-соединители
- встроенный L2 BMC Ethernet-коммутатор

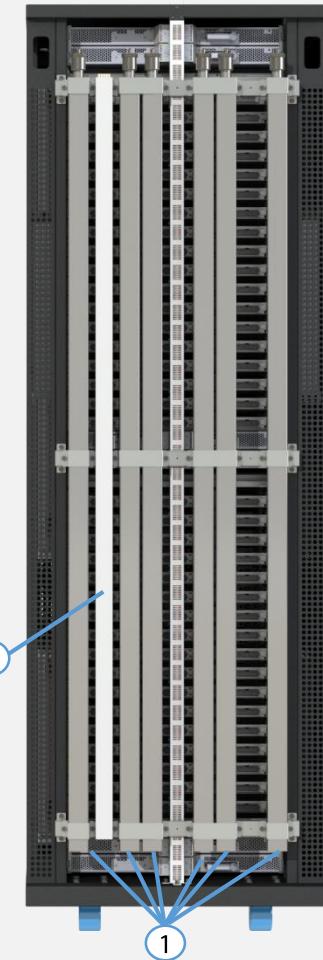


ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ШКАФ «НТ» SUPERNOVA С ВНЕШНИМ ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

НОРСИ-ТРАНС



- 1 Вычислительные узлы (108шт)
- 2 Блоки питания 5+1
- 3 Защитные панели коммутаторов
- 4 Выдвижные ЛВС-коммутаторы (6 шт)
- 5 Вводы 3х фазного питания



- 1 3 пары внешних жидкостных шин с БРС
- 2 Кабельный органайзер BMC Ethernet
- 4 Боковые фальшпанели
- 5 Встроенные ЛВС-коммутаторы (leaf, BMC)

